

AFE4462 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE

1 特長

- 最大 16 位相セットの信号取得をサポート
- 最大 16 個の LED と 4 個の PD をサポート
- 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
- 異なるセンサから、異なるデータレートで同時に信号を取得
- 正確で連続的な PPG モニタリング
 - ウェアラブルデバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング: LED 15 μ A、レシーバ 15 μ A (標準値)
 - 115dB のピークシステム SNR
- トランスマッタ:
 - LED 電流を 25mA～250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
 - 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
 - LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
 - SpO2、多波長 HRM、分光で 16 個の LED を同時にサポート
- レシーバ:
 - 4 つの時間多重 PD 入力をサポート
 - 2 つの並列レシーバ (4 組の TIA / フィルタ)
 - 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255 μ A) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
 - 位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64 μ A) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
 - ADC 出力におけるデジタル環境減算
 - 帯域幅をプログラム可能なノイズ フィルタリング
 - トランシエンピーダンス ゲイン: 3.7k Ω ～1M Ω
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- システムクロックと同期してデータを取得するオプション
- 環境、LED の自動 DC キャンセル
- サンプル深度 256 の FIFO
- SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
- 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧: Rx: 1.7V～1.9V (LDO バイパス)、1.9V～3.6V (LDO 有効)、Tx: 3～5.5V、IO: 1.7-RX_SUP

2 アプリケーション

- ウェアラブル機器やヒアラブル機器用の光学式心拍数モニタリング (HRM)
- 心拍変動 (HRV)
- 酸素飽和度 (SpO2) の測定
- 分光

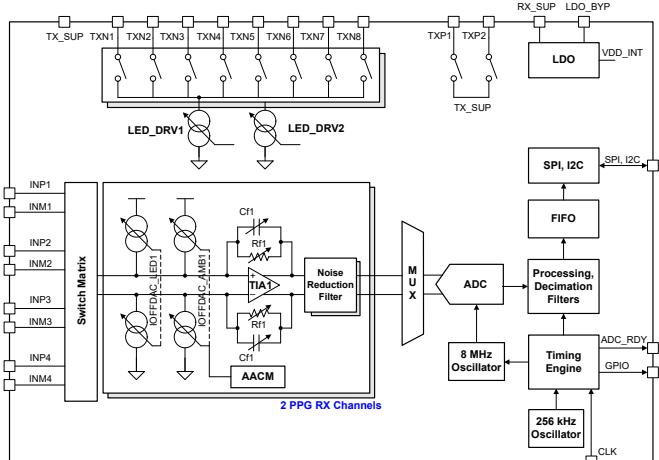
3 概要

AFE4462 は、心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管酸素飽和度(SpO2)等の光学的バイオセンシングに適したアナログ フロントエンドです。このデバイスは、16 個までのスイッチング発光ダイオード(LED)と 4 つまでのフォトダイオード(PD)をサポートできます。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミックレンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 16 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する 4 つの PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、256 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
AFE4462	DSBGA (36)	2.60mm × 2.60mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール(機械翻訳)を使用していることがあり、TIでは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長	1	5.2 サポート・リソース	3
2 アプリケーション	1	5.3 商標	3
3 概要	1	5.4 静電気放電に関する注意事項	3
4 改訂履歴	2	5.5 用語集	3
5 デバイスおよびドキュメントのサポート	3	6 メカニカル、パッケージ、および注文情報	3
5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	3		

4 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
December 2024	*	初版

5 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

5.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE4462YBGR	Active	Production	DSBGA (YBG) 36	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-20 to 85	AFE4462
AFE4462YBGR.A	Active	Production	DSBGA (YBG) 36	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-20 to 85	AFE4462

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

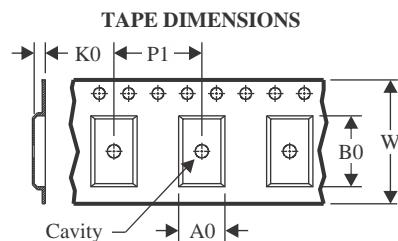
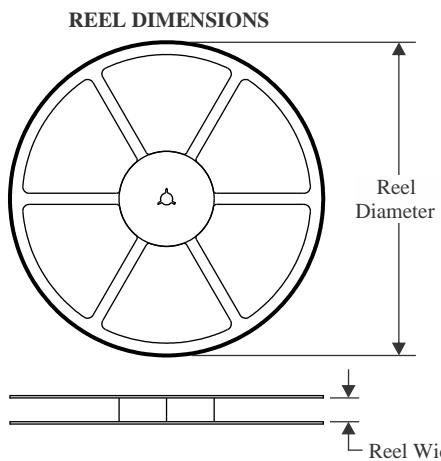
⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

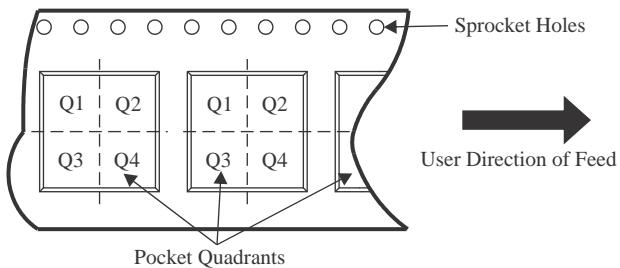
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



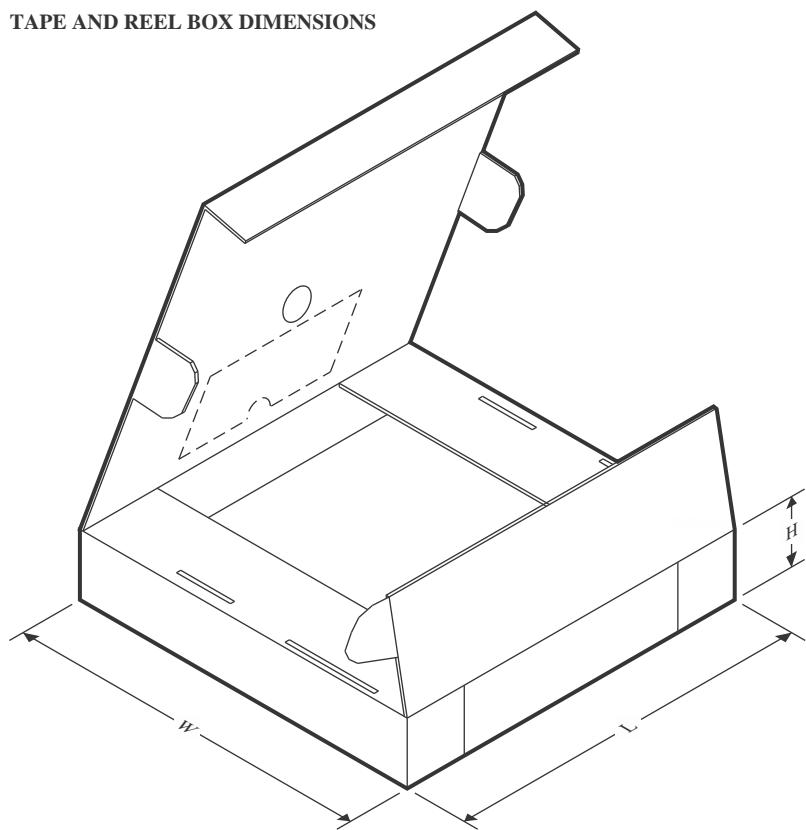
A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
AFE4462YBGR	DSBGA	YBG	36	3000	330.0	12.4	2.73	2.73	0.67	8.0	12.0	Q1

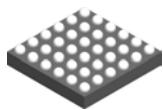
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
AFE4462YBGR	DSBGA	YBG	36	3000	345.0	365.0	55.0

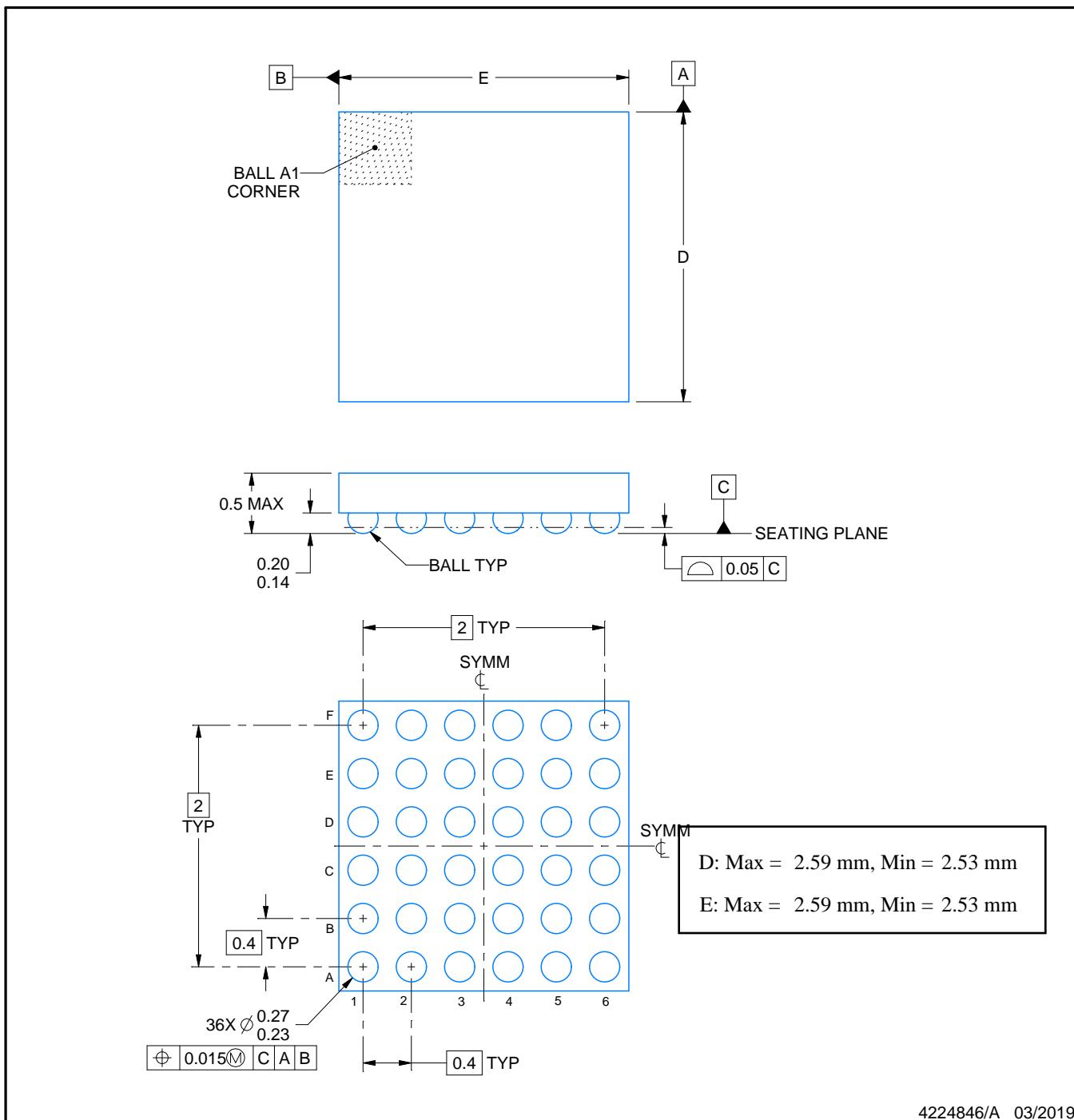
PACKAGE OUTLINE

YBG0036



DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



4224846/A 03/2019

NOTES:

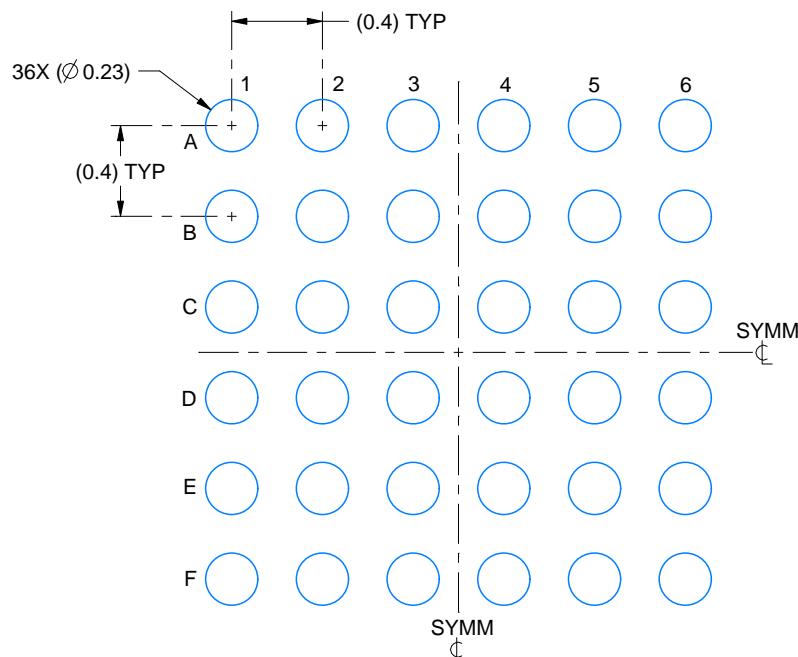
- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

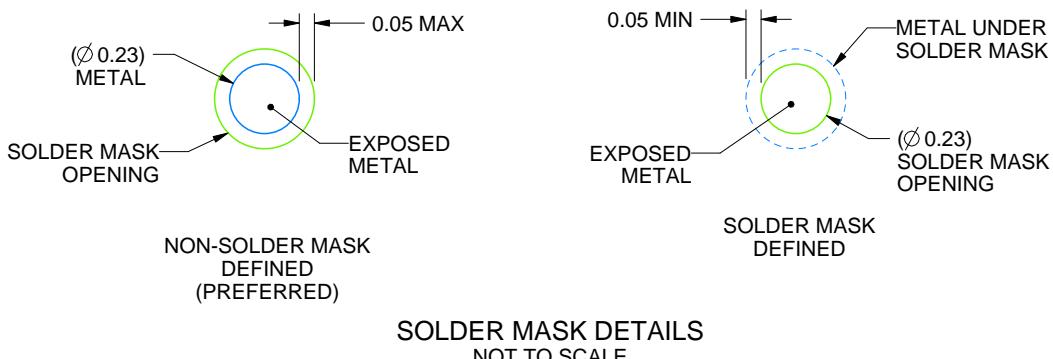
YBG0036

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X



4224846/A 03/2019

NOTES: (continued)

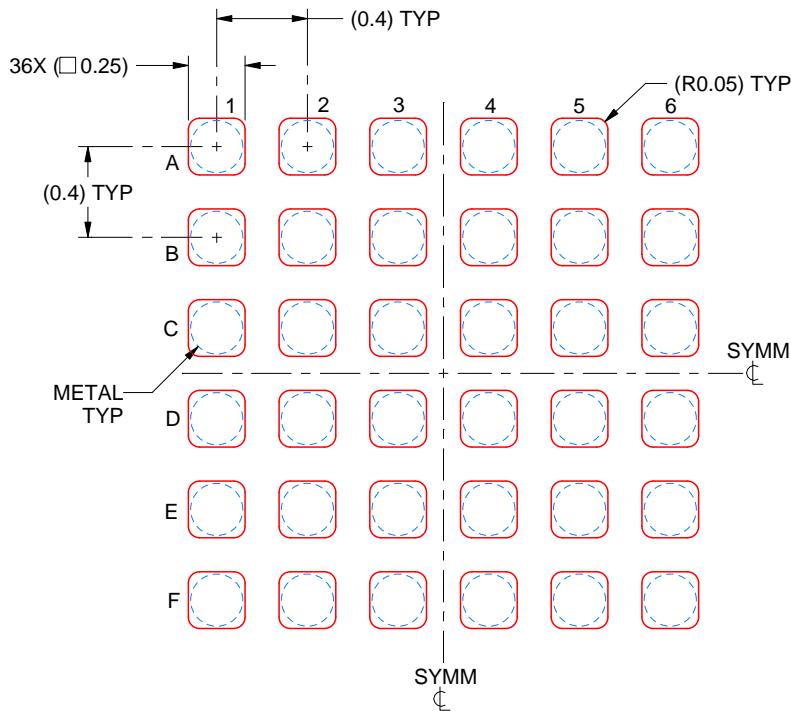
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YBG0036

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE: 30X

4224846/A 03/2019

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月